

05.4

(C) 1991

ДЖОЗЕФСОНОВСКИЕ КОНТАКТЫ *Nb-SiC-Nb*

И.Ю. Борисенко, В.М. Закосаренко,
 Е.В. Ильичев, В.И. Кузнецов,
 В.А. Тулин

Создание высококачественных джозефсоновских структур для реализации целого ряда криоэлектронных устройств до сих пор является актуальной задачей. На первое место здесь выходит технология изготовления контактов, которая должна удовлетворять следующим требованиям: а) возможность легко контролировать технологические операции, б) высокая степень воспроизводимости параметров. Кроме того, необходимо обеспечить надежность изготовленных структур при термоциклировании и их стабильность во времени. Поэтому в качестве сверхпроводника был выбран *Nb*, жесткий металл с достаточно высоким T_c (мягкие материалы при термоциклировании склонны к образованию острых выступов, разрушающих барьерный слой). Выбор *SiC* обусловлен уникальными свойствами этого материала: высокая химическая стабильность, стойкость в агрессивных средах, высокая твердость и однородность пленок, достаточно низкая диэлектрическая проницаемость. Напыление пленок *SiC* и *Nb* в едином вакуумном цикле и отсутствие процесса окисления позволяет более полно удовлетворить требованиям а) и б) по сравнению с альтернативными процессами.

Джозефсоновские контакты в форме сэндвича изготавливались следующим образом: а) отмыка подложек перед напылением; б) напыление *Nb*; в) оптическая фотолитография, травление *Nb*, снятие фоторезиста; г) напыление *SiC* и *Nb*.

Для напыления пленок использовалась магнетронная высокочастотная (13.56 МГц) напылительная установка с возможностью подачи смещения на подложку, *SCM 601 J (Alcatel)*. Охлаждение подложки отсутствовало. Использовался плоский магнетрон с диаметром мишени 150 мм, с водяным охлаждением. Расстояние мишень–подложка равнялось ≈ 60 мм. Остаточное давление $\approx 3 \cdot 10^{-7}$ мбар.

В качестве подложек использовались стандартные пластины монокристаллического *Si* диаметром 75 мм и толщиной ≈ 0.4 мм, а также пластины ситалла диаметром 40 мм.

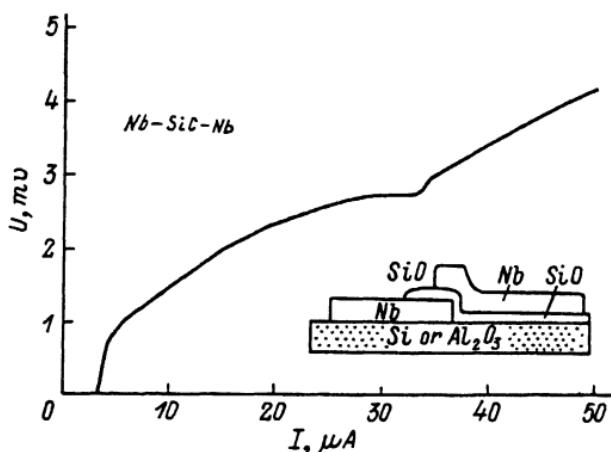


Рис. 1. Характерная ВАХ контакта. На вставке к рисунку схематически изображен поперечный срез структуры $Nb-SiC-Nb$.

Перед напылением подложки из Si проходили стандартную обработку: гидромеханическую отмытку, обработку в растворе Каро, отмытку в дейонизированной воде. Для ситалла использовалась лишь гидромеханическая отмытка в дейонизированной воде. После загрузки подложки в установку и достижения остаточного давления $\approx 10^{-6}$ мбар производилась очистка мишени перед распылением и одновременная очистка подложки подачей на нее смешения $V_{bias} \approx -300$ В. Мощность ВЧ генератора при этом составляла 1.1 кВт, давление $Ar \approx 6 \cdot 10^{-3}$ мбар, время очистки 40 с. Мишень при этом была отделена от подложки заслонкой. Затем смешение на подложке снижалось до -70 В, заслонка открывалась и со скоростью 25 Å/с напылялась пленка Nb толщиной 1000–2000 Å.

В стандартном процессе фотолитографии использовался позитивный фоторезист. После травления Nb промывки в дейонизированной воде, снятия фоторезиста и новой промывки напылялись слои SiC и Nb при условиях, аналогичных описанным ранее: после одновременной очистки подложки и мишени SiC смешение на подложке убиралось, а мощность генератора снижалась до 300 Вт, что соответствует скорости напыления $SiC \approx 3$ Å/с.

По истечении 20 секунд процесс прерывался, подложка переворачивалась к мишени Nb и после чистки мишени в течение 40 секунд на подложку напыляли Nb при мощности генератора 1.1 кВт, $V_{bias} = -70$ В со скоростью 25 Å/с. Далее процесс фотолитографии и жидкостного травления повторяли, в результате получалась структура, показанная на вставке к рис. 1.

Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) проводились в жидком гелии при $T=4.2$ К. Характерная ВАХ контакта представлена на рис. 1. Отметим ее основные особенности.

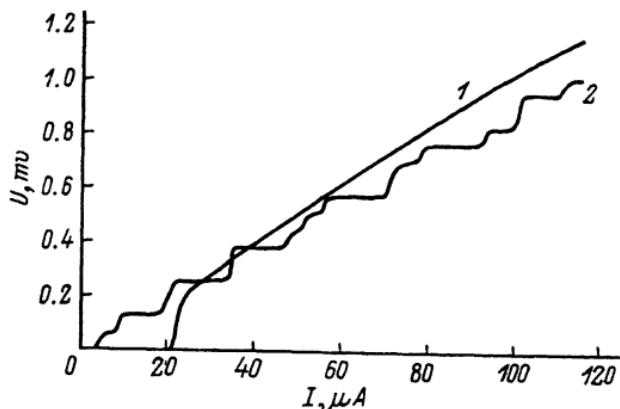


Рис. 2. Начальный участок ВАХ контакта в автономном режиме (1) и результат воздействия на контакт СВЧ сигнала с частотой 32 ГГц (2).

1) Величина щели $2d = 2.75$ мВ соответствует щели чистого Nb при 4.2 К. Это показывает на отсутствие диффузии между SiC и Nb и позволяет прогнозировать долговечность контакта. Здесь отметим, что использование кремния в качестве прослойки в переходах $Nb - Si - Nb$ приводит к образованию силицидов ниобия, о чем свидетельствует пониженное щелевое напряжение [1].

2) Значение характерного напряжения $V_0 = I_c R_N$, где R_N – нормальное сопротивление джозефсоновского контакта, I_c – его критический ток, составляет $\approx (2-8) \cdot 10^{-4}$ В, а R_N меняется в диапазоне $10-10^2$ Ом.

3) Безгистерезисность ВАХ. В рамках резистивной модели джозефсоновского контакта это означает, что безразмерная емкость переходов β не превышает единицы [2].

Перечисленные свойства контактов показывают перспективность использования их в сквичах постоянного тока и для приема СВЧ сигналов. На рис. 2 представлена ВАХ образца при воздействии на него СВЧ сигнала с частотой 32 ГГц. Здесь наблюдается серия вертикальных ступенек тока при напряжениях $V_n = hf n / 2e$, где f – частота СВЧ сигнала, $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$. Для данного образца удалось разрешить ступеньки до $n = \pm 20$. Величина ступенек осциллирует при изменении мощности СВЧ излучения.

Для получения информации о прослойке нами были исследованы пленки SiC толщиной 60–400 Å при помощи обратной электронографии и оже-спектроскопии. На электронограмме рефлексы и кольца отсутствовали, что говорит об аморфности пленок. Оже-спектроскопия показала отсутствие примесей в исследуемых образцах.

В заключении отметим следующее:

1) Малая емкость контакта и малое, по сравнению с „щелевым“ напряжение V_0 дают основание полагать, что здесь мы имеем дело с шунтированным туннельным контактом.

2) Отсутствие значительного избыточного тока указывает на то, что в реализованных структурах отсутствуют сверхпроводящие закоротки.

Мы надеемся в дальнейшем уточнить приведенные в конце работы выводы.

Список литературы

- [1] Гудков А.Л., Лихарев К.К., Махов В.И. //
Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 23. С. 1423-1428.
[2] Бароне А., Патерно Дж. Эффект Джозефсона.
М.: Мир, 1984. 639 с.

Поступило в Редакцию
28 декабря 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 6

26 марта 1991 г.

05.2; 07

© 1991

ОСОБЕННОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ
В СПЛАВАХ $Hg_{1-x}Mn_xTe$ И $Hg_{1-x}Cd_xTe$

Е.И. Георгиев, В.И. Иванов - Омский,
В.М. Погорлецкий, В.А. Смирнов,
А.Н. Титков

С целью изучения влияния обменного взаимодействия электронов с ионами марганца на релаксацию электронных спинов в настоящей работе изучалась оптическая ориентация в сплаве $Hg_{1-x}Mn_xTe$ ($x=0.23$, $N_A - N_D \sim 3 \cdot 10^{15}$ см $^{-3}$ при 77 К) и близких по параметрам энергетического спектра сплавах $Hg_{1-x}Cd_xTe$ ($x=0.69$, $N_A - N_D \sim 1.1 \cdot 10^{16}$ см $^{-3}$, при 77 К); ($x=0.61$, $N_A - N_D \sim 10^{14}$ см $^{-3}$ при 77 К) при температуре 4.2 К. Измерялась степень циркулярной поляризации [1] фотолюминесценции, возбуждаемой циркулярно поляризованным излучением лазеров, на длинах волн 1.52 мкм и 1.15 мкм. Энергия кванта возбуждения выбиралась таким образом, чтобы его превышение над величиной запрещенной зоны было минимальным. Плотность возбуждения достигала 10 Вт/см 2 .

На рис. 1 представлены спектры фотолюминесценции для исследованных образцов при 4,2 К в отсутствии магнитного поля. Ранее было показано, что природа наблюдаемых полос фотолюминесценции соответствует излучательной рекомбинации свободных электронов с дырками, находящимися на акцепторах или в валентной